



平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年1月26日

上場会社名 信越化学工業株式会社

上場取引所 東 大 名

コード番号 4063

URL <http://www.shinetsu.co.jp/>

代 表 者

代表取締役社長 森 俊三

問合せ先責任者

取締役経理部長 笠原 俊幸

TEL (03) 3246 - 5051

四半期報告書提出予定日 平成24年2月13日

配当支払開始予定日 -

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト、機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第3四半期の連結業績 (平成23年4月1日～平成23年12月31日)

(1) 連結経営成績 (累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第3四半期	791,435	△1.3	117,633	3.2	125,429	3.4	75,627	△14.3
23年3月期第3四半期	802,174	20.0	114,024	35.0	121,335	33.6	88,212	50.3

(注) 包括利益 24年3月期第3四半期 37,108百万円(△6.2%) 23年3月期第3四半期 39,576百万円(-)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第3四半期	178.12	-
23年3月期第3四半期	207.75	-

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
24年3月期第3四半期	1,764,594	1,462,872	80.6	3,349.38
23年3月期	1,784,166	1,469,429	80.0	3,360.39

(参考) 自己資本 24年3月期第3四半期 1,422,125百万円 23年3月期 1,426,808百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	-	50.00	-	50.00	100.00
24年3月期	-	50.00	-		
24年3月期(予想)				50.00	100.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年3月期の連結業績予想 (平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	1,065,000	0.6	155,000	3.9	165,000	2.9	102,000	1.9	240.23

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

当資料に記載の業績見通し等の将来に関する記述は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた記述であり、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績等は、様々な要素によりこれら業績見通し等とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績等に影響を与え得る重要な要素には、当社及び当社グループ会社の事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向、対米ドルをはじめとする円の為替レートなどが含まれます。ただし、業績等に影響を与え得る要素はこれらに限定されるものではありません。

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	24年3月期3Q	432,106,693株
	23年3月期	432,106,693株
② 期末自己株式数	24年3月期3Q	7,512,358株
	23年3月期	7,510,657株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	24年3月期3Q	424,595,168株
	23年3月期3Q	424,599,726株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は実施中であり、あります。

【添付資料】

添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	P. 2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	P. 2
(2) 連結業績予想に関する定性的情報	P. 3
2. 四半期連結財務諸表	P. 4
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	P. 6
(3) 継続企業の前提に関する注記	P. 8
(4) セグメント情報	P. 8
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	P. 8

(補足資料) 四半期業績の推移

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期連結累計期間の世界経済は、アジア地域では中国やインドで内需を中心に景気拡大が続いた一方で、欧米では停滞感が見られ、需要家の多くが先行きを警戒する状況が続きました。日本経済は、東日本大震災の影響や、円高の進行、欧州での信用不安の波及懸念などもあり依然として厳しい状況が続きました。

このような状況のもとで、当社グループは、世界の幅広い顧客への積極的な販売活動を展開するとともに、生産の効率化や新規製品の開発に努めてまいりました。

なお、東日本大震災により操業の停止を余儀なくされた当社の鹿島工場と信越半導体(株)の白河工場は、グループの総力をあげた取組みにより、被災した全ての生産拠点の復旧が昨年6月末に完了いたしております。

当第3四半期連結累計期間の業績といたしましては、売上高は、前年同期に比べ1.3% (107億3千9百万円) 減少し、7,914億3千5百万円となりました。営業利益は、前年同期に比べ3.2% (36億9百万円) 増加し、1,176億3千3百万円となり、経常利益も、前年同期に比べ3.4% (40億9千4百万円) 増加し、1,254億2千9百万円となりました。

また、当第3四半期連結累計期間の四半期純利益は、前年同期において移転価格課税に対する日米相互協議の合意による過年度法人税等の戻り入れがあった一方、当第3四半期連結累計期間において東日本大震災による特別損失を計上したことなどにより、前年同期に比べ14.3% (125億8千5百万円) 減少し、756億2千7百万円となりました。

塩ビ・化成品事業

塩化ビニルは、米国住宅市場の長期的な低迷が続く中、米国シンテック社が世界中の顧客への拡販により高水準の出荷を継続し、業績を大きく伸ばさせました。また、オランダのシンエツPVC社も出荷が堅調に推移しました。一方、国内事業は、需要家の生産調整の影響や輸出価格低迷の影響もあり、厳しい状況が続きました。

この結果、当セグメントの売上高は、前年同期に比べ16.0% (340億2千4百万円) 増加し2,470億9千4百万円となり、営業利益は、前年同期に比べ41.9% (60億1千3百万円) 増加し203億6千5百万円となりました。

シリコーン事業

シリコーンは、国内販売では上半期は電気、電子、化粧品用などを中心に堅調に推移したものの、下半期に入り国内の一部顧客でアジア向け輸出が振るわなかった影響を受けました。また、海外では機能製品が堅調に推移した一方、汎用品が価格低迷の影響を受けました。

この結果、当セグメントの売上高は、前年同期に比べ5.1% (54億6千1百万円) 減少し1,021億1千3百万円となり、営業利益は、前年同期に比べ5.2% (13億4千9百万円) 減少し245億1百万円となりました。

機能性化学品事業

セルロース誘導体は、国内事業が建築材料用や工業用製品を中心に堅調に推移しました。ドイツのSEタイローズ社は、建築材料用や塗料用製品の需要回復や値上げにより堅調でした。また、オーストラリアのシムコア社は、金属ケイ素の市況上昇もあり堅調に推移しました。

この結果、当セグメントの売上高は、前年同期に比べ5.8% (35億5千5百万円) 増加し649億3千1百万円となり、営業利益は、前年同期に比べ13.8% (12億7千5百万円) 増加し105億2百万円となりました。

半導体シリコン事業

半導体シリコンは、上半期の前半においては、東日本大震災で被災した白河工場の早期復旧に取り組むとともに、他拠点での増産や在庫品の出荷で対応して参りました。上半期の後半以降は半導体デバイスメーカーの生産減や、ウエハーの在庫調整の影響を受けました。

この結果、当セグメントの売上高は、前年同期に比べ17.1% (375億1千5百万円) 減少し1,813億7千4百万円となり、営業利益は、前年同期に比べ2.4% (7億3千8百万円) 減少し305億5千6百万円となりました。

電子・機能材料事業

希土類磁石は、ハイブリッド自動車や省エネルギータイプのエアコン向けの出荷が好調で、原料価格の高騰分の販売価格への転嫁も進みました。フォトレジスト製品は、半導体デバイスの微細化の進展もあり堅調に推移し、高輝度LED用パッケージ材料も堅調でした。合成石英製品は、液晶用大型フォトマスク基板が堅調に推移し、光ファイバー用プリフォームは、東日本大震災で被災した鹿島工場が上半期前半に操業を停止していた影響を受けましたが、復旧後は出荷が回復しました。

この結果、当セグメントの売上高は、前年同期に比べ18.2% (192億9千8百万円) 増加し1,250億8千万円となり、営業利益は、前年同期に比べ2.7% (7億3千3百万円) 増加し279億6千4百万円となりました。

その他関連事業

信越ポリマー社の携帯電話用キーパッドは、タッチパネル方式のスマートフォン（高機能携帯電話）の普及の影響などもあり厳しい状況が続き、半導体ウエハー関連容器は半導体デバイスの生産調整の影響もあり出荷が振るいませんでした。エンジニアリング事業は堅調でした。

この結果、当セグメントの売上高は、前年同期に比べ25.8% (246億4千2百万円) 減少し708億3千9百万円となり、営業利益は、前年同期に比べ36.0% (20億7千8百万円) 減少し36億9千9百万円となりました。

(2) 連結業績予想に関する定性的情報

今期の見通しにつきましては、世界経済は欧州での信用不安などによる減速懸念もあり先行きは不透明であり、予断を許さない状況にあります。そのような中で国内でも、雇用情勢の悪化やデフレの影響も懸念されるなど、厳しい状況が予想されます。

当社グループは、直面する厳しい事業環境に対応するため、世界の幅広い顧客に積極的な販売活動を展開するとともに、特長ある製品を開発し新たな需要を開拓してまいります。また、技術や品質の向上に注力するとともに、原材料の安定的な確保に努めるなど、各事業の強化を推進してまいります。

業績予想（平成23年7月26日発表）に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	244,002	231,700
受取手形及び売掛金	270,499	276,362
有価証券	116,714	46,846
たな卸資産	188,283	258,163
その他	70,962	84,638
貸倒引当金	△2,534	△2,372
流動資産合計	887,927	895,338
固定資産		
有形固定資産		
機械装置及び運搬具(純額)	252,229	323,864
その他(純額)	368,104	271,749
有形固定資産合計	620,334	595,614
無形固定資産	14,020	12,622
投資その他の資産		
投資その他の資産	261,921	261,037
貸倒引当金	△38	△18
投資その他の資産合計	261,883	261,019
固定資産合計	896,238	869,256
資産合計	1,784,166	1,764,594

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	110,753	121,221
短期借入金	8,712	13,059
未払法人税等	21,072	14,634
災害損失引当金	24,401	6,718
その他の引当金	2,433	2,132
その他	82,061	80,337
流動負債合計	249,434	238,104
固定負債		
長期借入金	5,548	1,229
引当金	14,498	14,514
その他	45,255	47,874
固定負債合計	65,302	63,618
負債合計	314,737	301,722
純資産の部		
株主資本		
資本金	119,419	119,419
資本剰余金	128,177	128,177
利益剰余金	1,376,043	1,409,211
自己株式	△40,917	△40,923
株主資本合計	1,582,724	1,615,885
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,275	△2,120
繰延ヘッジ損益	895	546
為替換算調整勘定	△160,087	△192,186
その他の包括利益累計額合計	△155,916	△193,760
新株予約権	3,822	3,503
少数株主持分	38,798	37,242
純資産合計	1,469,429	1,462,872
負債純資産合計	1,784,166	1,764,594

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
売上高	802,174	791,435
売上原価	609,151	598,118
売上総利益	193,023	193,316
販売費及び一般管理費	78,998	75,682
営業利益	114,024	117,633
営業外収益		
受取利息	2,182	2,283
持分法による投資利益	9,854	7,219
その他	9,773	8,291
営業外収益合計	21,811	17,794
営業外費用		
為替差損	12,350	8,443
その他	2,150	1,554
営業外費用合計	14,501	9,998
経常利益	121,335	125,429
特別損失		
災害による損失	—	5,312
投資有価証券評価損	—	1,241
特別損失合計	—	6,554
税金等調整前四半期純利益	121,335	118,875
法人税、住民税及び事業税	33,625	35,013
過年度法人税等	△10,679	—
法人税等調整額	8,999	7,776
法人税等合計	31,945	42,789
少数株主損益調整前四半期純利益	89,389	76,085
少数株主利益	1,177	457
四半期純利益	88,212	75,627

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	89,389	76,085
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△4,019	△5,523
繰延ヘッジ損益	△87	△515
為替換算調整勘定	△43,317	△31,204
持分法適用会社に対する持分相当額	△2,388	△1,733
その他の包括利益合計	△49,812	△38,976
四半期包括利益	39,576	37,108
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	39,663	37,784
少数株主に係る四半期包括利益	△86	△675

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報

報告セグメントの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

1. 当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント							調整額 (注)	四半期連結 損益計算書 計上額
	塩ビ・ 化成事業	シリコーン 事業	機能性 化学品事業	半導体 シリコン事業	電子・機能 材料事業	その他 関連事業	計		
売上高									
外部顧客への 売上高	247,094	102,113	64,931	181,374	125,080	70,839	791,435	—	791,435
セグメント間の内部 売上高又は振替高	2,904	3,109	5,877	0	2,173	47,186	61,251	(61,251)	—
計	249,998	105,222	70,809	181,375	127,254	118,025	852,686	(61,251)	791,435
セグメント利益 (営業利益)	20,365	24,501	10,502	30,556	27,964	3,699	117,590	43	117,633

(注)セグメント間取引消去によるものです。

2. 前第3四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント							調整額 (注)	四半期連結 損益計算書 計上額
	塩ビ・ 化成事業	シリコーン 事業	機能性 化学品事業	半導体 シリコン事業	電子・機能 材料事業	その他 関連事業	計		
売上高									
外部顧客への 売上高	213,070	107,574	61,376	218,889	105,782	95,481	802,174	—	802,174
セグメント間の内部 売上高又は振替高	15,812	2,995	4,790	5	2,115	48,366	74,085	(74,085)	—
計	228,882	110,569	66,167	218,894	107,898	143,847	876,260	(74,085)	802,174
セグメント利益 (営業利益)	14,352	25,850	9,227	31,294	27,231	5,777	113,734	290	114,024

(注)セグメント間取引消去によるものです。

各セグメントに属する主要製品・サービス

セグメント	主要製品・サービス
塩ビ・化成事業	塩化ビニル樹脂、か性ソーダ、メタノール、クロロメタン
シリコーン事業	シリコーン
機能性化学品事業	セルロース誘導体、金属珪素、ポバール、合成性フェロモン
半導体シリコン事業	半導体シリコン
電子・機能材料事業	希土類磁石(電子産業用・一般用)、半導体用封止材、LED用コート材、フォトレジスト、マスクブランクス、合成石英製品、液状フッ素エラストマー、ペリクル
その他関連事業	樹脂加工製品、技術・プラント輸出、商品の輸出入、エンジニアリング

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

補足資料：四半期業績の推移

(単位：億円)

	2011年3月期					2012年3月期				
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	通期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第3四半期 累計	
	2010年 4-6月	2010年 7-9月	2010年 10-12月	2011年 1-3月		2011年 4-6月	2011年 7-9月	2011年 10-12月		
売上高	2,597	2,729	2,696	2,561	10,583	2,500	2,714	2,700	7,914	
塩ビ・化成品	704	761	666	704	2,835	675	926	870	2,471	
シリコン	354	363	359	355	1,431	355	350	316	1,021	
機能性化学品	195	207	212	221	835	208	214	227	649	
半導体シリコン	692	732	765	649	2,838	662	580	572	1,814	
電子・機能材料	338	358	362	356	1,414	360	405	486	1,251	
その他関連	314	308	332	276	1,230	240	239	229	708	
営業利益	361	400	379	352	1,492	400	404	372	1,176	
塩ビ・化成品	31	62	51	53	197	61	73	70	204	
シリコン	91	84	83	83	341	92	82	71	245	
機能性化学品	30	30	32	37	129	35	35	35	105	
半導体シリコン	94	116	103	76	389	104	107	94	305	
電子・機能材料	89	91	92	89	361	92	96	92	280	
その他関連	23	19	16	15	73	17	10	10	37	
経常利益	390	422	401	390	1,603	422	421	411	1,254	
当期純利益	357	266	259	119	1,001	238	272	246	756	
減価償却費	213	240	240	244	937	191	205	222	618	
設備投資	285	297	245	372	1,199	206	216	155	577	
研究開発費	85	95	81	112	373	83	96	90	269	
海外売上高	金額	1,598	1,768	1,712	1,644	6,722	1,589	1,811	1,770	5,170
	比率※	62%	65%	63%	64%	64%	64%	67%	66%	65%

※連結売上高に占める割合